

機能材料事業

長年培ってきた高度な金属加工技術を駆使し、フレキシブル回路基板等に用いられる圧延銅箔や、コネクタ・半導体リードフレーム等に用いられるチタン銅、コルソン合金、りん青銅といった高機能銅合金条の供給、貴金属めっき・プレス加工等をグローバルに展開しています。



JX金属(株)
常務執行役員 機能材料事業部長 技術本部審議役
百野 修

重点戦略

- 主力製品である圧延銅箔／高機能銅合金条の用途拡大、収益力強化
- 事業拡大に向けた生産体制整備

2021年度の振り返り

新型コロナウイルス感染拡大、働き方改革の進展等により、テレワーク・オンライン教育の普及など生活様式の変化が進んでおり、スマートフォン・タブレット・PC等の電子デバイス分野、基地局・データセンター等の通信インフラ分野をはじめ、当社製品の主力市場は引き続き需要が拡大しました。それに対し、2020年度に稼働を開始した圧延銅箔・銅合金条増産設備について、年間を通じてフル生産を継続、足元の需要拡大に対応し増産・増販を達成しました。今後も拡大する需要に対し、さらなる効率化・生産性改善の実現、グループ各拠点における製造設備の増強等により、生産体制の拡充および事業基盤の強化を進めていきます。

2022年度の見通し

当社の高機能材料に対する需要は、中国における新型コロナウイルス感染拡大に伴うロックダウンの影響による需要の先行き不透明感はあるものの、電子デバイス・通信インフラ向け等最先端分野においては、引き続き需要が拡大しており、当社高機能材料に対する需要も拡大が継続しています。また、SDGs・ESGや脱炭素社会が進展する中で、電気自動車・電動車市場、リサイクル・省エネ関連向け等、新たな用途での需要の拡大、求められる材料特性の高機能化・多様化が予想されます。当社としては、市場のニーズの変化を先読みした市場開発・技術開発を推進していくとともに、拡大する需要に対し、さらなる生産体制の強化に努めます。

TOPICS

JXフィリピンにおけるFPC向け圧延銅箔表面処理工程の能力増強について

FPC(フレキシブルプリント基板)向け圧延銅箔の需要拡大に対応するため、2022年1月にJX Nippon Mining & Metals Philippines, Inc.(JXフィリピン)において圧延銅箔表面処理の設備導入が完了、稼働を開始しました。本投資の立ち上げにあたり、設備メーカーの技術者がコロナ禍における入国制限によりフィリピンへの入国が困難な中、リモートでの立ち上げを実現し、量産稼働を開始することができました。

本投資は、グループ全体での生産能力増強を実現すると同時に、これまで日立事業所に偏っていた生産能力に対して、JXフィリピンでの生産能力増加によりBCP強化にも貢献するものとなります。

当製品は、世界でもトップシェアを有しており、今後とも社会が必要とする素材を提供していくため、市場の動向に即した供給体制を構築し続けます。



圧延銅箔表面処理の設備

薄膜材料事業

世界最高水準の非鉄金属製造技術を駆使し、半導体向け用途を含む多種多様なスパッタリングターゲットをはじめ、化合物半導体材料、高純度金属および表面処理事業など、各種高機能デバイス、最先端IT機器、医療機器、電気自動車へと応用できる製品・事業をグローバルに展開しています。



JX金属(株)
執行役員 薄膜材料事業部長 技術本部審議役
諏訪邊 武史

重点戦略

- 需要に応じた機動的な供給体制構築
- 新規製品、新規事業開発力の強化
- IT化推進による製造工程のさらなる効率化

2021年度の振り返り

2021年度は、デジタルトランスフォーメーションの加速による市場全体の成長を背景にテレワークやオンライン関連需要が増大し、半導体関連市場は好調に推移しました。市場の拡大を背景として、世界的な半導体のひっ迫とそれに対応するため顧客各社が増産を行ったため、半導体用スパッタリングターゲットなど当事業の主力製品においても非常に強い需要が持続した1年となりました。

当社では半導体用スパッタリングターゲットにつき既に2020年度に生産能力を引き上げ、これらの設備稼働を本格化させることで需要の拡大に対応しました。さらに、足元の需要拡大ならびに将来的な市場ニーズへ応えていくことを目指し、本製品の生産能力を大幅に強化すべく、既存拠点の生産能力の強化に加え、国内外での新工場建設に着手し、生産体制の拡充および事業基盤強化を一層加速させることとしました。

2022年度の見通し

2022年度は、引き続きデジタルトランスフォーメーションの伸張は続いている一方、一方で世界的に進展しているインフレ、ロシアのウクライナ侵攻等の影響による経済環境の不透明さが増えています。しかしながら、特に半導体関連市場では、第5世代移動通信システム(5G)の本格化、車両の電装化、脱炭素化関連の電子機器の増大など、さまざまな分野での市場の成長が期待されており、中長期的な観点では、当事業部の先端材料のニーズはさらに拡大する見込みです。

これらの需要拡大に応えるべく、新工場の建設をはじめとした設備投資を着実に実行し生産能力を引き上げることで、顧客の信頼に応えていきます。また、当社の製品を通じてSDGsの実現に貢献していくとともに、さまざまな市場の変化に伴う新規開発動向に目を配り、社内外との連携により課題を解決することで社会の期待にも応えていく所存です。

TOPICS

半導体用スパッタリングターゲットの生産能力拡大

薄膜材料事業の主要製品である半導体用スパッタリングターゲットは、主に最先端のロジックやメモリーの微細配線材料に用いられており、データ社会の進展により着実に需要が伸び続けています。テレワークなどを背景とする通信インフラやモバイル端末の需要増大により、半導体市場の成長は加速しています。この基調は5Gやデジタルトランスフォーメーションの進展により今後も継続するものと予測しています。

当社は半導体の微細な配線の形成に用いる銅・銅合金、チタン、タンタルなどのスパッタリングターゲットの製造設備について、2020年度比約80%増の能力増強を行い、今後も需要拡大に応えるために尽力していきます。



半導体用スパッタリングターゲットの設備、電解槽(磯原工場)